Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système

L'IMS, créé le 1er janvier 2007 suite au regroupement de 3 laboratoires, est une unité mixte de recherche (UMR 5218) rattachée au CNRS, à l'Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB) et à l'Université Bordeaux 1 Sciences et Technologies.

Effectif du laboratoire ~ 400 personnes :
- 137 chercheurs et enseignants-chercheurs
- 70 personnels administratifs et techniques
- 158 doctorants
- 30 post-doctorants

Les différents moyens technologiques de l'IMS se retrouvent dans :
- 1 centrale de technologie
- 1 centrale d'analyse et de caractérisation
- 1 centrale du vivant
- 1 plate-forme « véhicule du futur »

IMS a 3 cellules de transfert vers l'industrie :
- IMS formation
- EURELNET
- A2M

Ainsi que 3 laboratoires communs avec l'industrie :
- STMicroelectronics
- PSA
- TOTAL

Et 1 Groupement d'Intérêt Scientifique avec THALES (GIS Albatros)

L'IMS est une composante du pôle TI de l'Université de Bordeaux

cnrs dépasser les frontières · Université Bordeaux 1 Sciences Technologies · IPB Institut Polytechnique Bordeaux · Université de Bordeaux

ims BORDEAUX

Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système
(CNRS UMR 5218)

Directeur	Pascal FOUILLAT
Directeurs adjoints	Valérie VIGNERAS Claude PELLET Jean-Paul BOURRIERES
Adresse	351 cours de la Libération F-33405 TALENCE CEDEX
Téléphone	+33 5 40 00 65 40 +33 5 40 00 24 00 (P3S)
Fax	+33 5 56 37 15 45
Email	info@ims-bordeaux.fr
Site internet	www.ims-bordeaux.fr

STRUCTURE OPERATIONNELLE

4 POLES	10 GROUPES	28 EQUIPES
PSI *Les systèmes et leurs interactions* B. VEYRET	**COGNITIQUE** *J.-M. ANDRE*	▪ Cognitique et ingénierie humaine (**CIH**) ▪ Ergonomie des systèmes complexes (**ERGO**)
	BIOELECTRONIQUE *S. RENAUD*	▪ Bio-Electromagnétisme (**BIO-EM**) ▪ Systèmes électroniques en interaction avec la biologie (**ELIBIO**) ▪ Architectures de réseaux de neurones sur Silicium (**AS2N**)
P3S *Du système au système de système* X. MOREAU	**PRODUCTIQUE** *B. VALLESPIR*	▪ Modélisation d'entreprise et ingénierie (**MEI**) ▪ Ingénierie de la conception (**ICO**) ▪ Pilotage des systèmes de production (**PSP**)
	SIGNAL *Y. BERTHOUMIEU*	▪ Modèles stochastiques n-D et méthodes d'estimation algébriques et stochastiques (**MODEST**) ▪ Détection et estimation pour des systèmes de télécommunications et de localisation (**DESTIN**) ▪ Analyse d'images et de volumes texturés (**VOLTIGE**)
	AUTOMATIQUE *A. OUSTALOUP*	▪ Approche robuste et intégrée de l'automatique (**ARIA**) ▪ Commande robuste d'ordre non entier (**CRONE**) ▪ Flatness and Fault Tolerant Guidance **(FFTG)**
PCS *Du composant au système* Y. DEVAL	**CONCEPTION** *J.-B. BEGUERET*	▪ Conception de circuits (**EC2**) ▪ Circuits et systèmes hyperfréquences (**CSH**) ▪ Circuits et systèmes numériques (**CSN**)
	FIABILITE *E. WOIRGARD*	▪ Evaluation des dispositifs micro et nano-assemblés (**EDMINA**) ▪ Packaging, assemblage et compatibilité électromagnétique (**PACE**) ▪ Puissance (**PUISSANCE**)
	NANOELECTRONIQUE *T. ZIMMER*	▪ Test et analyse par faisceau laser (**LASER**) ▪ Modélisation compacte et caractérisation des dispositifs électroniques (**MODEL**) ▪ Evaluation et fiabilité des technologies hyperfréquences (**III-V**)
PMC *Du matériau au composant* C. PELLET	**MICROSYSTEMES** *C. DEJOUS*	▪ Microsystèmes de détection à ondes acoustiques (**MDA**) ▪ Matériaux micro-assemblés pour micro-systèmes (**MMM**)
	MATERIAUX *V. VIGNERAS*	▪ Electronique organique (**ELORGA**) ▪ Matériau fonctionnalisé pour les hyperfréquences et l'optique (**MHYPOP**) ▪ Caractérisation électromagnétique de matériau et télédétection (**CEMT**)